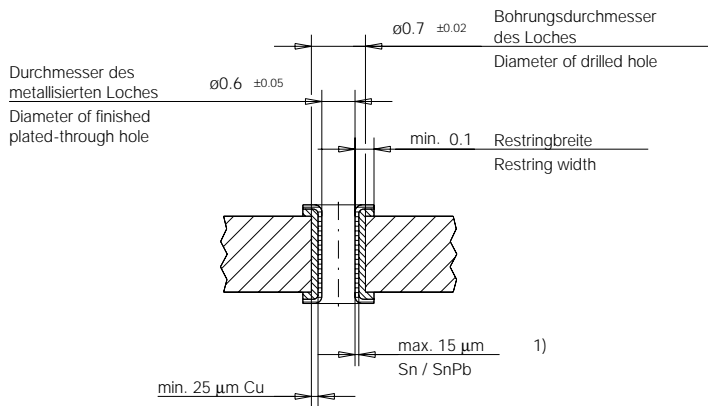


Schichtaufbau im metallisierten Loch für ERmet ZD Steckverbinder

Plated-thru-hole specification for ERmet ZD connectors

Schichtaufbau im metallisierten Loch (IEC 60352-5) mit **Nenn Durchmesser $\varnothing 0.6$ mm**
 für Einpress-Signalkontakte und Kontakte der Schirmbleche (Einpress- und Thru Hole Reflow- Version)
 Plated thru-hole specification (IEC 60352-5) with **nominal diameter $\varnothing 0.6$ mm**
 for pressfit signal contact and contact of the shielding (pressfit and thru hole reflow version)



- 1) Werden andere Oberflächentechniken, wie z.B. NiAu, chem. Sn oder Cu blank eingesetzt, sind die angegebenen Maße für Bohrungsdurchmesser, Durchmesser des metallisierten Loches, Restringbreite und die Mindestschichtdicke von Cu einzuhalten.
 Ein mögliches Überschreiten der oberen Toleranz von Maß "Durchmesser des metallisierten Loches" wird durch eine entsprechende Cu-Schichtdicke vermieden.

For other platings, such as NiAu, chem. Sn or blank Cu the recommended dimensions have to be respected for the diameter of drilled hole, diameter of plated-thru hole, rest ring width and min. thickness of Cu plating.
 To keep the max. tolerance for the "Diameter of finished plated-thru hole" the according thickness of the Cu-plating has to be used.